

大连百傲化学股份有限公司

关于与苏州芯慧联半导体科技有限公司拟签订《战略合作协议》的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、拟签订协议基本情况

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟签署战略合作协议的议案》，同意公司与苏州芯慧联半导体科技有限公司（以下简称“芯慧联”）签订《战略合作协议》，双方计划在半导体设备业务方面开展深度合作。具体内容详见公司于2024年2月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于与苏州芯慧联半导体科技有限公司拟签订〈战略合作协议〉的公告》（公告编号：2024-005）。

二、进展情况

上述《战略合作协议》已于2024年2月7日完成签署，协议的内容与《大连百傲化学股份有限公司关于与苏州芯慧联半导体科技有限公司拟签订〈战略合作协议〉的公告》（公告编号：2024-005）之“三、拟签订协议的主要内容”一致。

三、风险提示

本次签订的协议为双方基于合作意向而达成的战略框架性约定，具体合作内容和实施细节等尚待进一步落实和明确，另行签订的具体合同的签订时间、合同金额、实际执行金额等均存在不确定性。公司将密切关注协议相关事项的进展，并按照有关法律法规及时履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请投资者注意

投资风险。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2024年2月8日